

2026年1月7日

各位



### 【出展のお知らせ】

#### 第40回ネプコン ジャパン -エレクトロニクス開発・実装展-

当社は「第40回ネプコン ジャパン -エレクトロニクス開発・実装展-」に出展いたします。今回は「基板」をテーマに外部/内部検査装置やスマートファクトリー向けAMR搬送ロボットによる自動化についてデモ等を通じてご紹介いたしますので、この機会に是非、当社ブースにお立ち寄りください。



会期：2026年1月21日（水）～1月23日（金）

開場時間：10:00～17:00

会場：東京ビッグサイト

当社ブース：東ホール E16-32

問い合わせ先：(株)南陽 産機事業本部 ASS部 [TEL:092-473-7711](tel:092-473-7711)

産機事業本部 東京支店 [TEL:03-3666-8405](tel:03-3666-8405)

#### 【デモ及び展示内容】

- 最新の実装後基板検査装置ラインアップのデモ（内部、外観、立体再現、AI）
  - ナノフォーカス／マイクロフォーカス／ハイパワーモードでマルチに行える『X線CT検査装置』のデモ
  - X線のCT画像を立体的に3Dオブジェクト化して直感的に操作することで内部構造を各段に把握しやすくできる『空間再現ディスプレイ』のデモ
  - 業界最大の2,500万画素カメラモジュールでSMT基板の69mm×69mm領域をインラインで一括撮像し、不良分類検査ができる『2D/3D基板外観検査機』のデモ
  - 位相偏光技術／光干渉技術／無影灯技術を盛り込んだ工業用リング照明(PHASERAY®)を搭載した『デジタルマイクロスコープ』
  - 目視によるX線検査装置のICパッケージの内部画像検査を後付けモジュールで自動化できる『AIワイヤー外観ソフトウェア』の紹介

2. 半導体、電子部品業界向け世界納入台数1位のスマートファクトリー向け  
『AMR搬送ロボット』による自動搬送デモ
3. 実装基板の防湿コーティングを行う『塗布装置』の実演デモ
4. 製造工程内や装置内部の異常や作業ミスをビデオカメラの監視画像からAIで  
判断し瞬時に警告できる『動的監視AIソフトウェア(DIME)』のご紹介

**【その他パワー半導体向けソリューション】**

- ・MWIRを使用したホットスポット・熱分布の可視化ソリューション
- ・実装前のパッケージIC製造工程向け外観選別機
- ・人にも環境にもやさしい、水オンリーでの基板洗浄ソリューション
- ・アルミ線接合界面の異常を非破壊・非接触で検査できるソリューション
- ・自動化装置向けRPAソフトウェアソリューション  
(エラー解除・復元、設定入力支援をAIが自動で判断、対応)

【来場登録 URL】

<https://www.nepconjapan.jp/tokyo/ja-jp/register.html?code=1552093092185752-3GS>

【ブース位置】



当社ブース：E16-32

【展示ブースイメージ】

以上